



连接器 > PCB 连接器 > 内存卡连接器 > SIM 卡连接器



兼容卡: 3FF SIM

位数: 2

装载位置数量: 12

端子额定电流（最大值）: .5 A

电路应用: Signal

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
兼容卡	3FF SIM

结构特性

位数	2
装载位置数量	12

接触件特性

端子额定电流（最大值）	.5 A
-------------	------

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm
---------	---------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

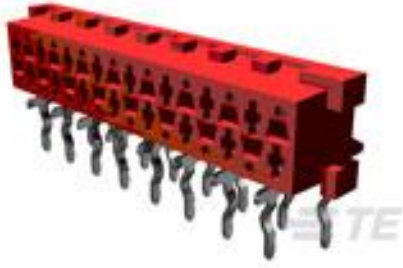


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

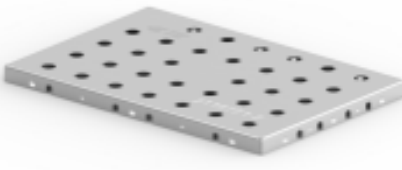
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号1-215460-2
MICRO-MATCH FEM.SE



TE 产品编号2118721-2
STD SHIELD COVER, CRS-38.60X25.90X2.00MM



TE 产品编号2174803-2
PUSH-PUSH MICRO SIM CONNECTOR



TE 产品编号4-2176091-1
RP 2A 0.25W 150R 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号4-2176325-9
CRGP 0402 100K 1%



TE 产品编号1-2176331-4
CRGP 2512 120R 1%



TE 产品编号2199230-4
M.2 0.5PITCH 4.2H KEY E 15U" AU"



TE 产品编号1-2295018-2
USB TYPE C, REC OFFSET 0.65MM DUAL SMT



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2296830-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2296830-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2296830-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。